

RADIANT

# etch Laser 2



直观

易学易用

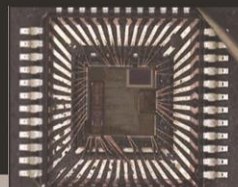
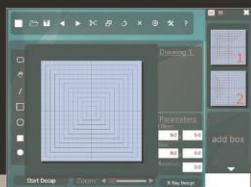
立刻开始开封

令人称奇的解决方案

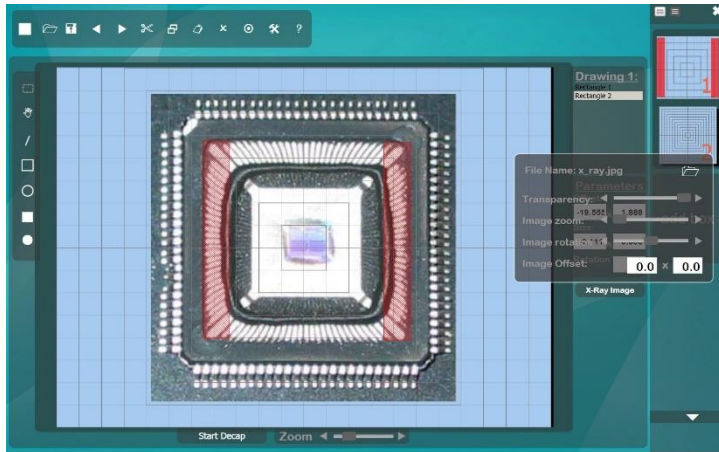
无损于焊线

用于铜线、金线、金银合金线

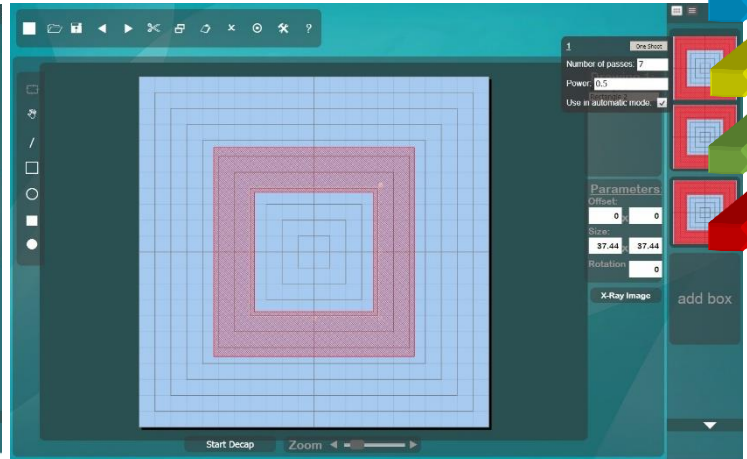
供全面的产品和服务，包括所有集成电路封装！



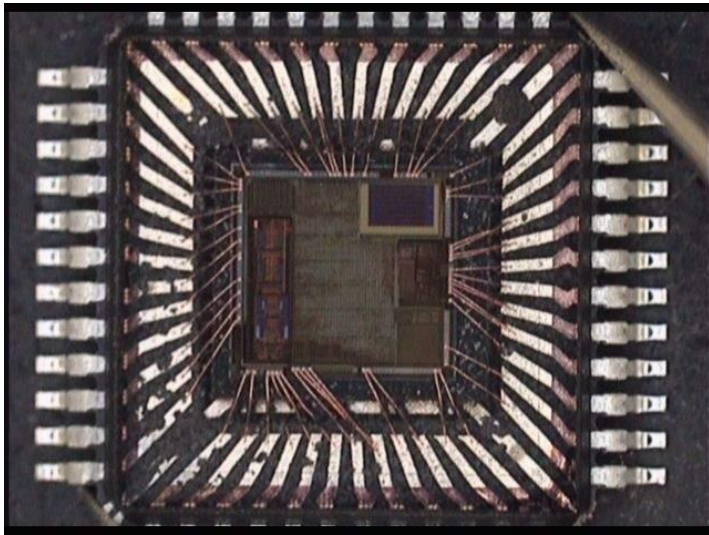
## 用户非常友好，易于使用的用户界面



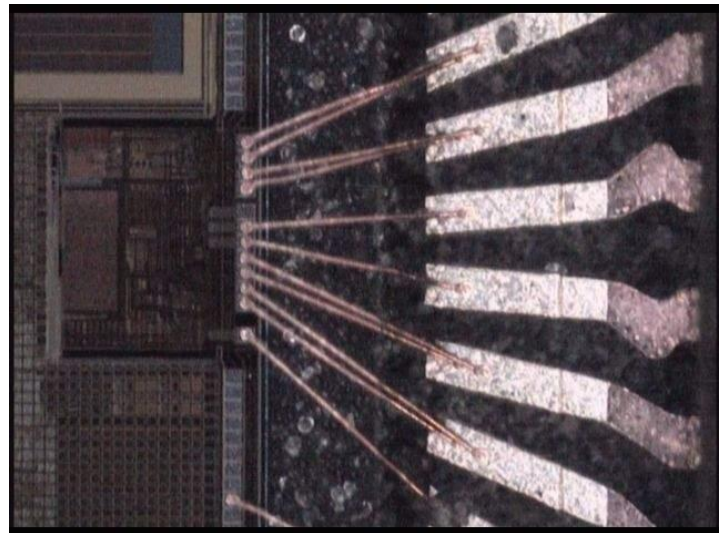
实时图像叠加



易于设置的激光边框



酸洗后完成



铜线依旧保存完好

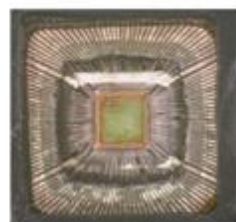
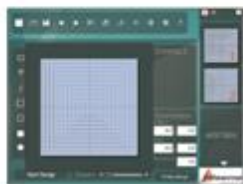
- 高功率激光系统能够完整的开封集成电路封装露出铜、铝、金线，而不会损坏它们。
- 如需电性验证，高效的激光系统可对芯片表面进行部分开封，以进行酸或化学清洗操作。
- 隔离样品室，防止交叉污染其他设备部件，提高使用寿命。
- 激光开封过程中的高分辨率实时视频。
- 有竞争力的功能和成本节约的效益！



# etch Laser

在提供自动开封技术和塑封腐蚀方面世界领先。

- \* 使用激光消蚀技术
- \* 可用于复杂形状的开封
- \* 可重复性
- \* 各种器件具有一致性
- \* 第二焊点无需使用酸处理
- \* 较高的激光安全特征
- \* 直观
- \* 易于学习和使用
- \* 安装完毕即可立即使用
- \* 叠加的图像可以调节透明度  
放大倍率、旋转角度和偏移量
- \* 焊线没有损伤
- \* 可用于铜线、金银线的开封
- \* 保留芯片表面100微米厚度用于追踪的酸处理
- \* 不会损伤框架上的镀银层和PCB上的绿油
- \* 最小的开口小于500微米



规格

激光:	高质量激光
激光类型	风冷1064纳米光纤激光器
功率	平均输出功率20w
脉冲宽度	9ns-200ns可选
频率	1Khz-1Mhz
激光质量	脉冲稳定性 <3%
扫描检流计	XY扫描镜检流计
激光镜头	F Theta镜头最大范围110mmX110mm
气冷	气冷集成控制器
安全等级	激光安全等级 1级
样品台	激光对中手动控制台
安全互锁	门设有安全互锁
烟尘处理	烟尘收集装置
控制单元	玻璃观察窗能有效防止激光伤害
实时图像	Windows兼容的消蚀软件
软件	图像叠加功能使参数设置非常容易 容易操作的用户界面
系统尺寸	1064mm X 700mm X 400mm
光学系统	带预览的实时视频观察系统
光学镜头	18x超大光学变焦: 8mm-140mm FOV
辅助聚焦	光点辅助聚焦
选项	
自动样品台	自动步进XY样品台

对中夹具提供40X40mm开孔



使样品始终  
位于中间

所有软件设定默认位于夹具中心



Distributors: